

公益社団法人精密工学会
プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会
第208回研究会開催のご案内

日時：2023年8月3日（木）
13:00～19:00
17:00～ 情報交換会

このたび、プラナリゼーション CMP 専門委員会では、下記の通り『今、聞きたい半導体技術』のテーマにて、第208回ハイブリッド研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。是非ご参加下さい。



開催場所：オンサイト(プラザエフ)およびオンライン会議システム Zoom によるハイブリッド開催

※オンライン参加の場合、参加用 URL は開催前日にご案内致します。
※開催日 2 日前の 8 月 1 日午前中までに参加登録をお願い致します。

プログラム：

13:00～ 13:10 開会挨拶（黒河委員長）

13:10～ 16:40 話題提供

テーマ：『今、聞きたい半導体技術』

13:10～ 13:15 趣旨説明（菅井幹事）

1) 13:20～14:10 「先端ロジックデバイスにおける配線技術動向」

IBM Research 本山 幸一 氏

<概要> 近年、バックエンド Cu 配線の微細化に伴い配線抵抗の増加や EM 短寿命化などの問題が起こっている。その為、Cu 配線の延命努力と並行して、Cu 配線以降の代替金属配線の研究が数多く行われている。Ru や Co 等の代替金属は Cu と比較して、電子散乱の少なさ、バリア/ライナーの薄膜化が可能であること、高融点であることなどから、20nm ピッチ以下の配線における配線抵抗の低減や EM 性能の向上が期待される。本講演では、Cu 配線の延命、代替金属配線導入における課題と対策、および今後の配線技術動向について紹介する。

2) 14:10～15:00 「ダイヤモンド半導体の最近の進展 —CMP への期待—」

佐賀大学大学院 嘉数 誠 氏

<概要> ダイヤモンド半導体は、SiC、GaN を超えるバンドギャップ(5.47eV)を有し、究極のパワー半導体として期待されている。ここ数年、ダイヤモンドウェハーの大口径化(2 インチ径)とダイヤモンド半導体デバイスの高性能化(有能出力電力 875MW/cm²) が急激に進んだ。講演では、これらの技術の進展を説明し、CMP の課題と期待を述べる。

.....
15:00～15:10 休憩
.....

3) 15:10～16:00 「後工程と前工程の融合による集積技術の革新と必要なプロセス」

横浜国立大学 井上 史大 氏

<概要> 世界の半導体企業は後工程やチップレットを重視しており、我が国も同様に動いている。その中でも Cu-Cu ハイブリッド接合は単なる後工程技術ではなく、前工程と後工程を結びつける重要なプロセスと位置づけられている。さらに後工程技術を使用して前工程の配線をシグナルと電送配線に分け DTCO を達成する BSPDN がロジック集積の新たな方向性として大きな注目を集めている。講演ではこれら集積技術の課題の共有や各社の解決策として示されているものを紹介する。

4) 16:00～16:40 「なんてこった!?! — 今(も)そこにある危機! Dinner Talk 編 —」

荏原製作所 辻村 学 氏

<概要> 企業人人生約半世紀、うち半導体業界に 40 年、そして愛すべき CMP に初めて会ってから既に 30 年以上経っています。光陰矢の如し、正にあつと言う間の半世紀でした。その間山あり谷あり、長い企業人生の中の小さな私が経験した危機の連続をご紹介します。何て言ったって今(も)そこに危機があるんですから! 題して私の「なんてこった!?!」人生をご紹介します。Dinner 前の Dinner Talk をお楽しみ下さい。

16:40～ 連絡事項・閉会挨拶

参加費（オンサイト/オンライン）

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円） ※会場参加：2名まで無料、3名以上の場合 ¥3,000/名
(オンライン参加は3名以上の参加も可：無料)
2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録）
3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）
※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。
※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。

※今回の研究会ではオンラインに Zoom（当研究会所有の正規ライセンス有償版）を使用させていただきます。

2023年8月3日（木）開催 第208回ハイブリッド研究会 参加申込書

オンサイト/オンライン（いずれかにチェックしてください）

氏名			
勤務先・所属			
連絡先	住所		
	TEL		FAX
	E-mail		

※ホームページからオンライン申し込みできます。

<http://www.planarization-cmp.org/registration>

問合せ先：「プラナリゼーションCMP 専門委員会」事務局（中村）
TEL：03-5962-3145, FAX：03-5962-3146, E-mail：nakamura@global-net.co.jp